

中国の需要増に対応して 人材・品質を強化

(株)フェローテックホールディングス
執行役員 代表取締役社長 グループCEO

賀 賢漢 氏 (63歳)に聞く



Q 会社の概要を教えてください

当社は、1980年にコンピューターシール、真空シール、磁性流体の輸入販売を目的として設立しました。その後、国内に工場を建設して磁性流体などの自社生産を進め、製品群も拡大してきました。現在では、コア技術である「磁性流体」と冷熱素子「サーモモジュール」の技術を応用した各種の製品が、エレクトロニクスや自動車、家電民生品、医療機器などの幅広い分野で採用されています。

現在、当社の全売上のうち、半導体などの装置関連が66%、電子デバイス関連が19%を占めます。半導体などの装置関連事業には真空シール、石英製品、セラミックス製品、装置部品洗浄など、電子デバイス関連事業には磁性流体、サーモモジュール、パワー半導体基板などが入ります。さらに自動車産業への提案も力を入れています。

Q 注力している事業は？

海外展開を積極的に進めています。特に半導体産業を中心として、さらに成長が続く中国における各種製品の生産拡大に注力しています。

例えば真空シールや金属受託加工事業は、杭州と常山の工場で行っています。当社の真空シール事業は、半導体

製造装置のような高真空環境が求められる装置に高性能なシールを提供しています。金属加工は、真空シールなどの製造現場で大型の工作機械を所有していることから、それらを受託加工に活用しています。中国では真空シールや金属加工技術が応用できる真空チャンバーやロボットパーツなどの需要が拡大しており、常山の工場で需要拡大に対応していく考えです。

シリコンパーツ事業は、半導体のエッチング工程で使用されるフォーカスリングや治具・消耗材を提供しています。高密度の3D NANDフラッシュメモリーの製造では、治具や消耗材の使用量も増える傾向にあります。この用途では石英製と比較してコンタミ発生が少なく、耐熱性・耐久性・耐摩耗性に優れるシリコンパーツが有効で、需要拡大が見込まれます。シリコンインゴットを製造する銀川の拠点で、加工・組立てまでの一貫生産体制による納期短縮を図るほか、大規模な増産体制の構築も検討しています。

パワーデバイス製品向けに、放熱用絶縁基板であるパワー半導体基板の製造にも力を入れています。上海と東台に工場を構え、東台で生産拡大を進めています。アルミナセラミックスを用いるDCB基板は、工作機械などの産業機器、エアコンを始め、家電製品のイ

ンバーターなどに多く使われています。窒化けい素や窒化アルミニウムを用いるAMB基板は、電気自動車や鉄道向けに今後需要が伸長すると考えています。さらに、アルミナセラミックスにめっきなどのメタライズを施すDPC基板の製造をスタートしました。これは高耐熱・高強度で光通信やパワーLEDなどに用いられます。

Q 今後の取組みは？

パワー半導体基板の生産能力を拡大している東台拠点の敷地内に、研究開発拠点「パワー半導体研究院」を建設予定です。同施設では、次世代パワー半導体基板や基板周辺技術の研究開発を主目的としますが、研究院を設けることで、持続的に優秀な人材を採用していきたいという考えがあります。

私は仕事を楽しむことをモットーとしています。企業規模が拡大する中、社員も笑顔で仕事ができるよう、満足度の高い職場環境の提供や、組織体制の改革を行っていきます。

本年5月に新中期経営計画を発表しました。そこで、2024年3月期に売上高1500億円、さらに2031年3月期に同3000億円の目標を掲げました。今後もさらに高品質の製品を提供していくとともに、優秀な人材の採用や育成を強化し、目標達成を目指します。